



日独ジョイントワークショップ ”半導体パッケージング” ～プリントドエレクトロニクスとの融合を目指して～

開催日 2026年9月14日（月）

開催時間

9:00-12:00 第一部 講演セッション（ドイツ）
13:00-17:00 第一部 講演セッション（日本）
17:00-18:30 第二部：ポスターセッション&ネットワーキング

開催場所

第一部 講演会場：工学部2号館 2階 223教室
第二部 ポスターセッション会場：工学部百周年記念会館
熊本大学黒髪南キャンパス
〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

アクセス

熊本駅からバスで約30分
駐車場に限りがある為、バスなどの公共交通機関をご利用ください。

参加費

無料

定員

150名

申込み

<https://forms.gle/M7MkhAQrSZh27KHE7>



日独ジョイントワークショップ
”半導体パッケージング”
～プリントエレクトロニクスとの融合を目指して～



プログラム

司会進行：高橋 辰宏（日独ジョイントワークショップ事務局長）

9:00 開会挨拶 熊本大学学長 小川 久雄

9:05 ご挨拶 フラウンホーファー日本代表部代表 三木 英哉 様

9:15 第一部：講演（ドイツ側）

（発表各30分）

- 9:15 **Electronic Microsystems and Flexible Hybrid Electronics at Fraunhofer EMFT**
Fraunhofer EMFT Christof Landesberger
- 9:45 **Advanced packaging technologies for flexible and stretchable Systems**
Fraunhofer IZM Julian Haberland
- 10:15 **The APECS pilot lines - a European perspective**
Fraunhofer IZM Erik Jung

10:45 休憩

（発表各20分）

- 11:00 **Where Flex Meets Precision – UV Light Source Technologies for High-Resolution Direct Imaging**
Schmoll Maschinen GmbH Dennis Pusch
- 11:20 **Ambient Rapid Metallization - A New Platform for Advanced Manufacturing**
Oreltech Natalia Zamoshchik
- 11:40 **Multiparametric sensor systems, such as highly integrable biosensor stickers (for FPCs and PCBs) - will revolutionize disposable wearables and single-use medical devices.**
AddSensors Eike Kottkamp

12:00 ミニポスター交流（軽食提供あり）

日独ジョイントワークショップ
”半導体パッケージング”
～プリントエレクトロニクスとの融合を目指して～



13:00 ご挨拶 自由民主党両院議員総会長 参議院議員 松村 祥史 様

13:10 ご挨拶 日本貿易振興機構（ジェトロ）イノベーション部エコシステム課長 真田 勇二

13:15 第一部：講演（日本側）

（発表各30分）

- 13:15 **Integrated FHE Based on Advanced Heterogeneous 3D Packaging Technology**
東北大学 福島 誉史
- 13:45 **熊本大学における半導体分野の高度人材育成に向けた研究・教育活動の取り組み**
熊本大学 青柳 昌宏
- 14:15 **Sustainable Flexible Hybrid Electronics for Smart Sensor Systems**
山形大学 時任 静士

14:45 休憩

15:00 第一部：ショートプレゼンテーション（日本側）

（発表各5分）

- 15:00 **JX金属の取り扱う先端パッケージおよびサーマルマネジメント向け先端素材群のご紹介**
JX金属株式会社 本橋 寛
- 15:05 **先端半導体分野に向けた技術紹介 ― ミクロンスケールTGV加工と三次元構造コールドプレート**
株式会社エンプラス 瀬尾 学
- 15:10 **Next Generation Packaging by Pressure Sintering Technology**
日機装株式会社 岡田 康弘
- 15:15 **次世代パワーモジュールに向けたパッケージング技術**
I-PEX株式会社 内村 竜平
- 15:20 **フラックスレスフォーミングガス・レーザダイボンディング技術**
澁谷工業株式会社 小村 成樹
- 15:25 **半導体新時代に向けた関連ビジネスへの期待**
金剛株式会社 田中 稔彦
- 15:30 **高精度かつ高調最先端デジタルスキャン光マスク描画機**
株式会社FSCE 村井 誠
- 15:35 **機能性表面処理の紹介**
株式会社オジックテクノロジーズ 飯干 美智雄
- 15:40 **2.5D/3D Chiplet Packaging Design and Verification Solutions**
シーメンスEDAジャパン株式会社 近藤 靖
- 15:45 **AI向け基板技術および設計サービスのご紹介**
兆發合同会社 Edison Yang

日独ジョイントワークショップ
”半導体パッケージング”
～プリントドエレクトロニクスとの融合を目指して～



- 15:50 **マイスティア企業紹介**
株式会社マイスティア 田中 瑞恵
- 15:55 **SIIX – Connecting Technology to Mass Production**
シークス株式会社 坂本 尚生
- 16:00 **半導体後工程への適用を見据えた新規金属粉の開発**
三井金属株式会社 越智 健太郎
- 16:05 **ニューロング精密工業のスクリーン印刷技術と機械設備の紹介**
ニューロング精密工業株式会社 藤村 保博
- 16:10 **ラボから市場へ：次世代プリントドエレクトロニクスを加速する高速印刷技術**
株式会社太陽機械製作所 川口 真平
- 16:15 **先端半導体パッケージにおけるディスパンスプロセスへのニーズと当社の取り組み**
武蔵エンジニアリング株式会社 上久保 尚
- 16:20 **メクテック：プリントドエレクトロニクスへの取り組みのご紹介**
メクテック株式会社 富永 梓己
- 16:25 **AIコンピューティングを支える銅ナノテクノロジー**
エレファンテック株式会社 木口 浩史
- 16:30 **メイコーでのPKG基板開発の取り組み**
株式会社メイコー 名屋 茂
- 16:35 **グラビアオフセット微細印刷技術の半導体製造プロセスへの提案**
株式会社小森コーポレーション 池田 英樹
- 16:40 **アディティブエレクトロニクスによる複合構造とその応用**
株式会社FUJI 富永 亮二郎

17:00 第二部：ポスターセッション&ネットワーキング（軽食提供あり）

17:00 ご挨拶 熊本県商工労働部産業振興局 産業支援課長 小松 篤史

ドイツ

Electronic Microsystems and Flexible Hybrid Electronics at Fraunhofer EMFT

Fraunhofer EMFT Christof Landesberger

Advanced packaging technologies for flexible and stretchable Systems

Fraunhofer IZM Julian Haberland

The APECS pilot lines - a European perspective

Fraunhofer IZM Erik Jung

Where Flex Meets Precision – UV Light Source Technologies for High-Resolution Direct Imaging

Schmoll Maschinen GmbH Dennis Pusch

Ambient Rapid Metallization - A New Platform for Advanced Manufacturing

Oreltech Natalia Zamoshchik

”半導体パッケージング”

～プリントエレクトロニクスとの融合を目指して～



Multiparametric sensor systems, such as highly integrable biosensor stickers (for FPCs and PCBs) - will revolutionize disposable wearables and single-use medical devices.“

AddSensors Eike Kottkamp

日本機関

Integrated FHE Based on Advanced Heterogeneous 3D Packaging Technology

東北大学 福島 誉史

3次元LSIチップ積層実装モジュールの基盤技術研究開発

熊本大学 青柳 昌宏

Sustainable Flexible Hybrid Electronics for Smart Sensor Systems

山形大学 時任 静士

日本企業

JX金属の取り扱う先端パッケージおよびサーマルマネジメント向け先端素材群のご紹介

JX金属株式会社 本橋 寛

先端半導体分野に向けた技術紹介 — ミクロンスケールTGV加工と三次元構造コールドプレート

株式会社エンプラス 瀬尾 学

Next Generation Packaging by Pressure Sintering Technology

日機装株式会社 岡田 康弘

次世代パワーモジュールに向けたパッケージング技術

I-PEX株式会社 内村 竜平

フラックスレスフォーミングガス・レーザダイボンディング技術

澁谷工業株式会社 小村 成樹

高精度かつ高諧調最先端デジタルスキャン光マスク描画機

株式会社FSCE 村井 誠

機能性表面処理の紹介

株式会社オジックテクノロジーズ 飯干 美智雄

2.5D/3D Chiplet Packaging Design and Verification Solutions

シーメンスEDAジャパン株式会社 近藤 靖

AI向け基板技術および設計サービスのご紹介

兆発合同会社 Edison Yang

マイスティア企業紹介

株式会社マイスティア 田中 瑞恵

ウルトラファインAOI SX7000シリーズ

インスペック株式会社 菅原 亮太

故障解析・材料分析サービスについて

日本マーテック株式会社 童 建益

くまもと半導体グリーンイノベーション協議会の取り組み

くまもと半導体グリーンイノベーション協議会 古財敦子

Electroninks導電性金属錯体インクのご紹介

シークス株式会社 坂本 尚生

半導体後工程への適用を見据えた新規金属粉の開発

三井金属株式会社 越智 健太郎

”半導体パッケージング”

～プリントドエレクトロニクスとの融合を目指して～



ニューロング精密工業のスクリーン印刷技術と機械設備の紹介

ニューロング精密工業株式会社 藤村 保博

ラボから市場へ：次世代プリントドエレクトロニクスを加速する高速印刷技術

株式会社太陽機械製作所 川口 真平

先端半導体パッケージにおけるディスペンスプロセスへのニーズと当社の取り組み

武蔵エンジニアリング株式会社 上久保 尚

メクテック：プリントドエレクトロニクスへの取り組みのご紹介

メクテック株式会社 富永 梓己

AIコンピューティングを支える銅ナノテクノロジー

エレファンテック株式会社 木口 浩史

メイコーでのPKG基板開発の取り組み

株式会社メイコー 名屋 茂

グラビアオフセット微細印刷技術の半導体製造プロセスへの提案

株式会社小森コーポレーション 池田 英樹

アディティブエレクトロニクスによる複合構造とその応用

株式会社FUJI 富永 亮二郎

熊本大学

3次元LSIチップ積層実装モジュールの基盤技術研究開発

青柳 昌宏

GaN HEMTの放熱性向上のためのグラファイトカーボンとAu/Au加圧接合技術

分島 彰男

ASIC/SoC開発の低コスト化とeFPGA IPの小面積化

飯田 全広

LHAR テスト構造を用いたイメージングエリプソメトリーによるALD-Al₂O₃膜厚

均一性評価

西里 洋

3次元積層LSIシステム 設計技術と応用

大川 猛

山形大学

SEMI Standards Activities

Electronic components using soft substrates with three-dimensional shapes

古川 忠宏

Flexible Ribbon Sensors: From 2D To 1D Systems

松井 弘之

Development of FHE Devices for IoT sensors

熊木 大介

次世代光電変換デバイスへの挑戦：山形大学における有機/ペロブスカイト太陽電池および近赤外OLEDの研究開発

佐野 健志

Sustainable Flexible Hybrid Sensor Systems Enabled by Printing Technology

吉田 綾子

18:30 閉会挨拶 山形大学学長 出口 毅